

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
【発行日】 令和 5 年 6 月 7 日(2023.6.7)

【公開番号】 特開 2022-40197(P2022-40197A)
【公開日】 令和 4 年 3 月 10 日(2022.3.10)
【年通号数】 公開公報(特許)2022-043
【出願番号】 特願 2022-58(P2022-58)
【国際特許分類】

H 0 5 K 1/14(2006.01)

H 0 5 K 3/46(2006.01)

H 0 1 L 23/12(2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/14 G

H 0 5 K 3/46 B

H 0 5 K 3/46 Q

H 0 5 K 3/46 E

H 0 1 L 23/12 N

【手続補正書】

【提出日】 令和 5 年 5 月 30 日(2023.5.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 発明の名称

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明の名称】 配線基板

【手続補正 2】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 配線基板よりも微細な配線を形成されて第 2 配線基板の接合面に前記第 1 配線基板が接合され、前記第 2 配線基板の前記接合面と反対側の面に半導体素子が実装される配線基板であって、

前記半導体素子と接合する第 1 電極を、前記第 2 配線基板の前記接合面と反対側の面に有し、

前記第 1 配線基板と接合する第 2 電極を、前記第 2 配線基板の前記接合面に有し、

前記第 2 電極と接合する第 3 電極を、前記第 1 配線基板の一方の面に有し、

前記第 1 配線基板と前記第 2 配線基板との間およびそこから延伸し、前記第 2 配線基板の外周よりも外側にはみ出す部分をもつ封止樹脂を有し、

前記封止樹脂の前記はみ出す部分が、その最も高い部分において、前記第 2 配線基板の厚さ方向上端から下端の間のいずれかに位置し、

前記最も高い部分が、前記第 1 配線基板主面と平行な平面をなすことを特徴とする、配線基板。

【請求項 2】

前記第 1 配線基板が、導体層と絶縁体層を含む多層構造であることを特徴とする、

請求項 1 に記載の配線基板。

10

20

30

40

50

【請求項 3】

前記第 2 配線基板が、導体層と絶縁体層を含む多層構造であることを特徴とする、
請求項 1 または 2 に記載の配線基板。

【請求項 4】

前記封止樹脂が、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、ポリエステル樹脂、オキセタン樹脂およびマレイミド樹脂の 1 種又はこれらの樹脂の 2 種以上が混合された樹脂を成分として含有することを特徴とする、

請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の配線基板。

【請求項 5】

前記封止樹脂が、フィラーとして、シリカ、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化マグネシウムおよび酸化亜鉛の 1 種又はこれらの 2 種以上が混合されたものを含有することを特徴とする、

請求項 4 に記載の配線基板。

10

20

30

40

50